

Manufacturing



Automatic electrolytic Ni-Au plating equipment

LED 基板・フレキシブル基板

電解 Ni-Au めっき/電解 Ni-Ag めっき

～特徴～

当ラインでは、FPC・LED 基板を中心に生産しております。その中でも薄物製品を得意としています。電解光沢 Ni-Ag の専用ラインを設けており、LED 基板を得意としております。

～生産能力～

◎対応製品サイズ

電解 Ni-Ag ライン：サイズ (MAX) 510×610mm 約 7,000 m²/Month

電解 Ni-Au ライン：サイズ (MAX) 510×610mm 約 14,000 m²/Month

◎対応めっき仕様

電解 Ni めっき 0.50～15.0 μm (硬質・軟質)

電解 Au めっき 0.01～0.20 μm (硬質)

電解 Au めっき 0.03～0.80 μm (軟質)

電解 Au めっき 0.10～0.80 μm (ダイレクト軟質)

電解 Ag めっき 1.00～4.00 μm (光沢)

◆フリップチップ実装及び屈曲性を必要とする FPC に対応するダイレクト Au めっきも対応可能です。

◇ニッケル及び、金の組み合わせは自在です。硬質めっき・軟質めっきと選択することも出来ます。御社からのご要望に応じ提案・検討もさせていただきます。

【各ライン写真】

1号機 硬質 Ni-Ag

2号機 硬質・軟質 AuF

3号機 硬質・軟質・ダイレクト Au



東電化工業 株式会社

Azuma Denka Industry Co.,Ltd. Company Profile